

DAIICHI INSTITUTION INDUSTRY CO.,LTD

浮上式ピンセット

(製品の御紹介)

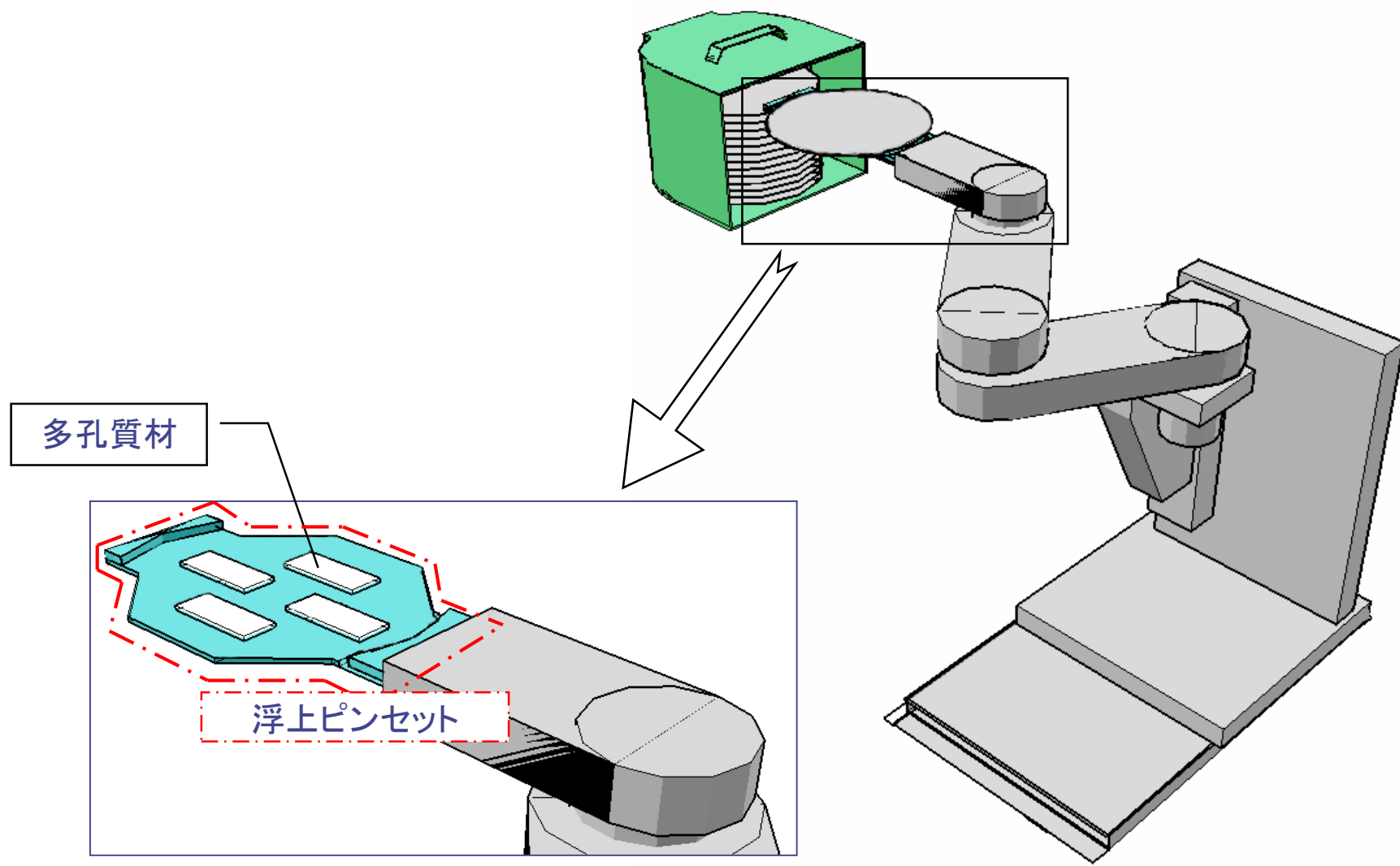
1.コンセプト

浮上式ピンセットは、半導体ウェハーを非接触でハンドリングする為のピンセットです。

裏面処理を行なった後のウェハーに対して傷、汚れなどの発生を防ぎます。

材質、形状（サイズ）など使用用途に合わせた製品の設計、組立てを行うことが可能です。

2. 浮上式ピンセットの基本構成(使用配置)



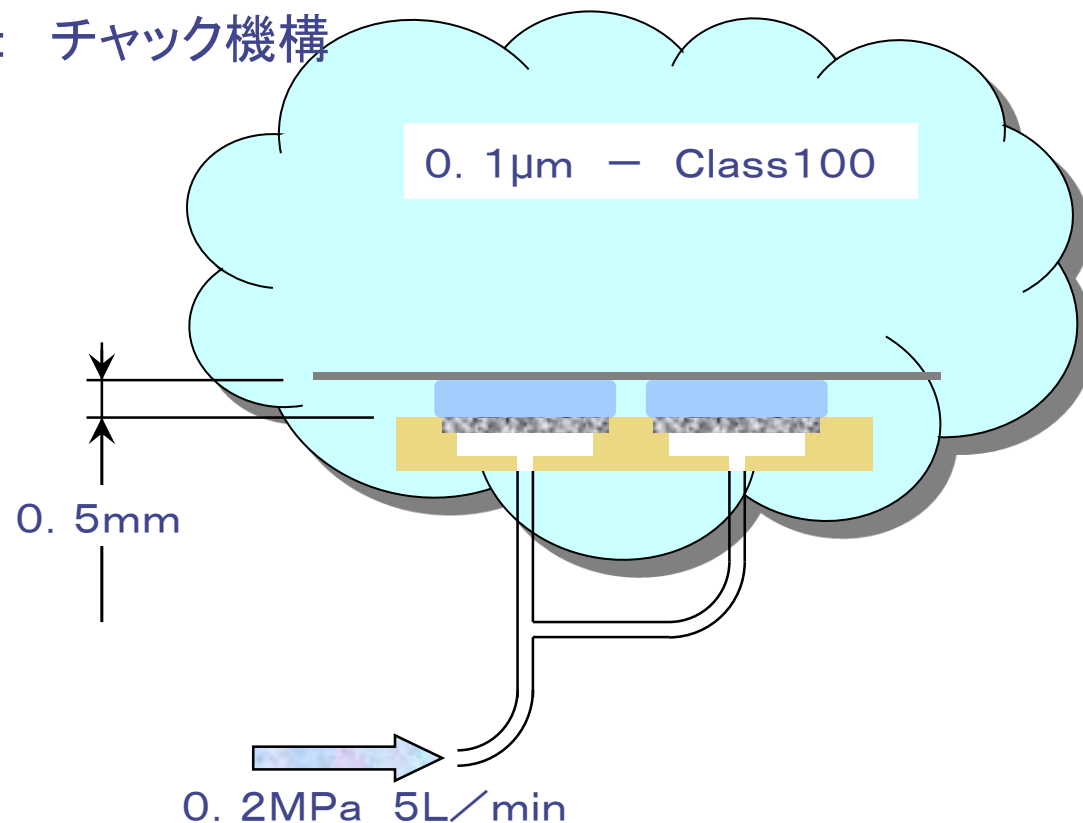
3. 仕様(スペック)

清浄度 : 0.1 μ m - Class100

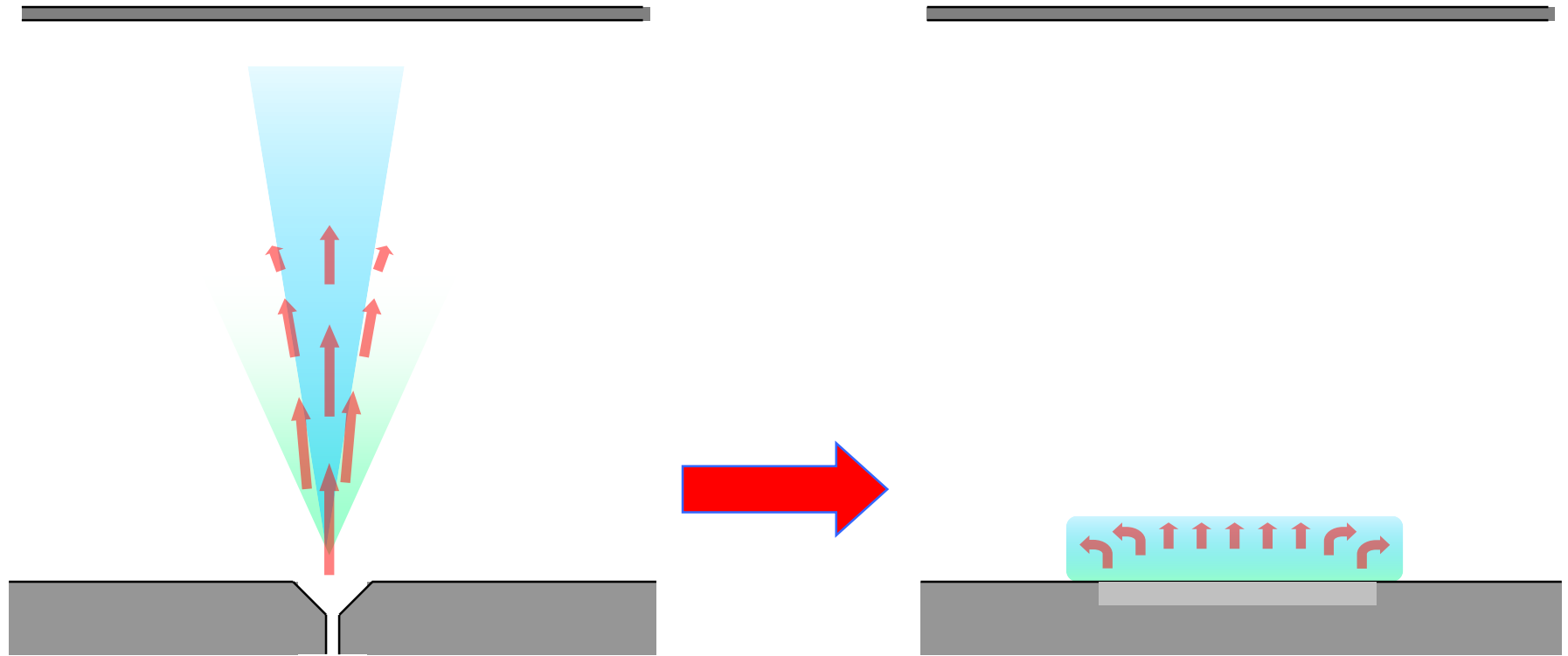
必要流量 : 0.2MPa 5L/min

浮上量 : 0.5mm

オプション : チャック機構



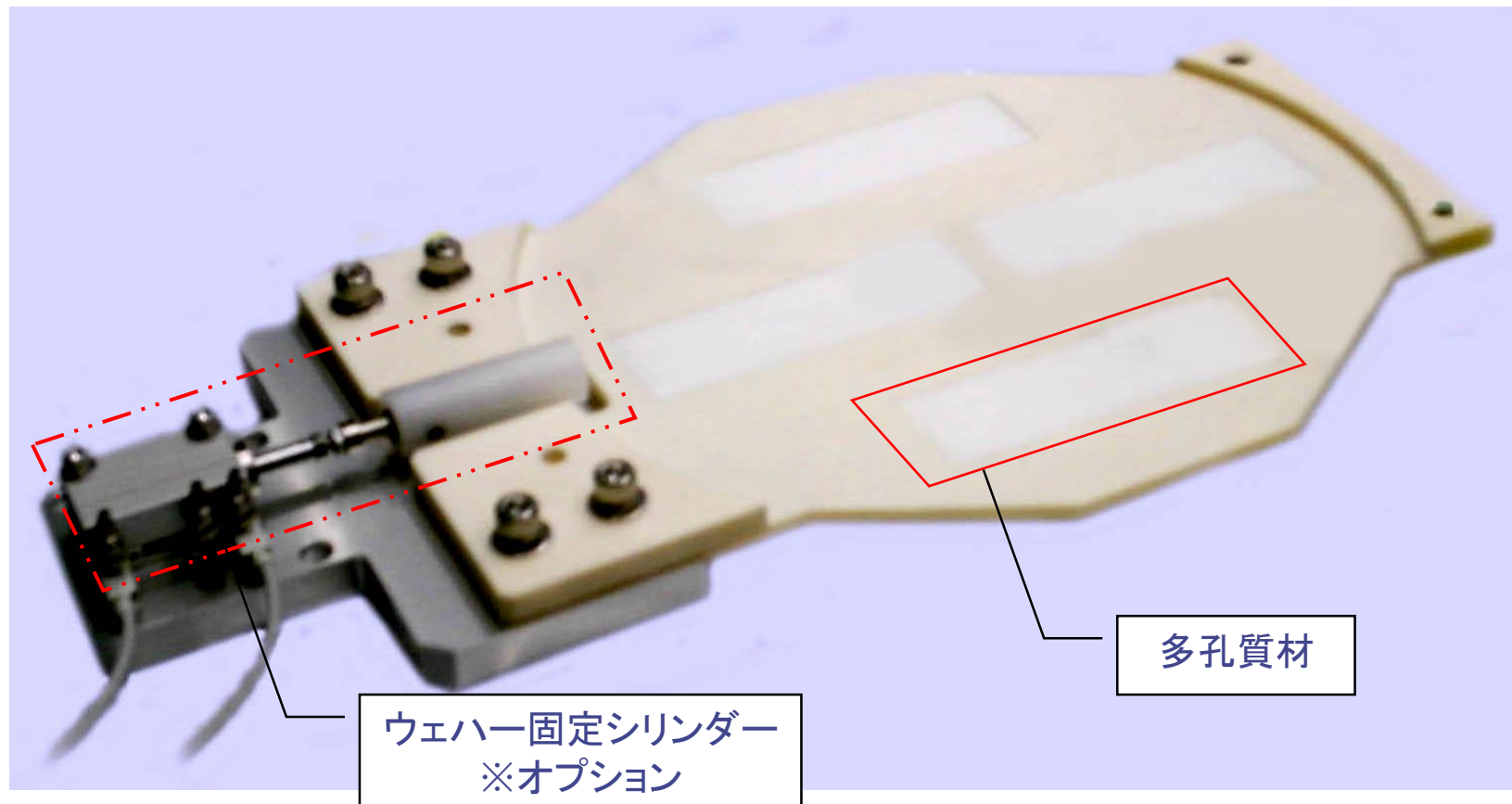
4. 浮上ピンセットの浮上原理



従来品

浮上ピンセット

5-1. 製品画像①



5-1. 製品画像②

